

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月7日(07.08.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/164325 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/023 (2006.01) H10K 59/10 (2023.01)
C08G 73/10 (2006.01) H10K 59/122 (2023.01)
G03F 7/004 (2006.01) H10K 59/124 (2023.01)
H10K 50/00 (2023.01) H10K 85/10 (2023.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2025/001131
- (22) 国際出願日: 2025年1月16日(16.01.2025)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2024-012642 2024年1月31日(31.01.2024) JP
特願 2024-098509 2024年6月19日(19.06.2024) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 (JP).
- (72) 発明者: 佐伯 昭典 (SAEKI Akinori); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP). 亀本 聡 (KAMEMOTO Satoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP). 越野 美加 (KOSHINO Mika); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP). 磯部 王郎 (ISOBE Kimio); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, CURED PRODUCT, DISPLAY DEVICE, AND ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、硬化物、表示装置、および電子部品

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a photosensitive resin composition which has good solubility in a thinner, which can suppress tainting of an opening part after being cured and suppress foaming during lamination, and from which a cured product having good light emission characteristics even after being subjected to a reliability test is obtained; a cured product obtained by curing the photosensitive resin composition; and a display device and an electronic component equipped with a cured product of the resin composition. A photosensitive resin composition according to the present invention contains: a resin (A) including a specific structural unit (hereinafter referred to as resin (A)); a photosensitive agent (B); and a solvent (C). When the total amount of diamine residues in the resin (A) is defined as 100 mol%, the total of the content of a specific diamine residue is 30-100 mol%.

(57) 要約: 本発明は、シンナー溶解性が良好であり、キュア後の開口部汚染の抑制、積層時の発泡抑制が可能であり、かつ、硬化物が信頼性試験後も良好な発光特性を有する感光性樹脂組成物、前記感光性樹脂組成物を硬化した硬化物、および前記樹脂組成物の硬化物を具備した表示装置、電子部品を提供することを目的とする。本発明の感光性樹脂組成物は、特定の構造単位を含む樹脂(A)(以下、樹脂(A)と呼ぶ)と、感光剤(B)と、溶剤(C)を含有し、前記樹脂(A)のジアミン残基の総量を100mol%とした場合、特定のジアミン残基の含有量の合計が30~100mol%である。

[続葉有]

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）